

聚氨酯灌封胶

ICM-HG309

技术参数表

TECHNICAL DATASHEET

一、产品特点及应用 Characteristic & Application

- 1, ICM-HG309 为双组份树脂体系, 固化后形成黑色固体。
- 2, 由聚氨酯树脂合成, 所生产的制品具有优异的柔韧性和耐高低温和防水性能。
- 3, 广泛应用于各类电源模块、传感器、电子元器件的防水封装。
- 4, 对电器元件无腐蚀, 对钢、铝、铜、锡等金属及橡胶、塑料、木材等材质有较好的粘接性。
- 5, 耐温范围: -50-130

二、固化前性能 As supplied

项目	检测单位/方法	A 组 份	B 组 份
外 观	目测	黑色液体	褐色透明液体
粘 度	mpa·s	13000±2000	150±50
配 比	重量比	5:1	
密 度	25°C g/cm ³	1.65±0.05	1.2±0.05
AB 剂混合粘度	mpa·s	4000~6000	
可操作时间	100g / 25°C	20~30 分 钟	
固化时间	hr/°C	初步固化: 2~3 小时, 可加热 60 度 3~4小时	

三、固化后性能 As cured

项目	单位	数值	检测方法
固化物颜色	——	黑色固体	目视
硬度	SHORE D	65±5	GB/T 531. 1-2008
介电强度	KV/mm	>20	GB/T 1693-2007
固化物密度	25°C g/cm ³	1.55±0.05	GB/T 13354-921
体积电阻率	Ω·cm	>1.45x10 ¹⁴ 次方	GB/T 1692-92
伸长率	%	≥20	GB/T 528-1998
导热系数	W/m.k	0.8	ASTM D5470
阻燃等级	UL94	V0	GB/T 2408-2008
表面电阻率	Ω·cm	8.71*10 ¹⁴	GB/T 1692-92
介电常数	——	3.53	GB/T 1693-2007

四、使用工艺及注意事项 How to apply

- 1, 使用前先把 A、B 组分在容器内充分搅拌均匀。
- 2, 应遵守 A 组分: B 组分=5:1 的重量比, 并搅拌均匀。
- 3, AB 胶料混合后应真空排泡 3~5 分钟。
- 4, A 组分长期放置可能有少量的沉淀, 使用前请搅拌均匀, 不影响性能。
- 5, 胶水的适宜储存湿度为: $\leq 70\%$, 湿度大时, 湿气会大量粘附在底板表面, 同时湿气会与聚氨酯反应, 从而对产品的粘接性能、花斑、气泡有不良影响。

五、包装规格及贮存运输 Packaging, Storage and Delivery

- 1、包装: A 胶: 20kg/桶; B 胶: 4kg/桶
- 2、贮存: 25℃以下本产品的贮存期为 6 个月, 超过保存期限的产品应确认无异常后方可使用。
- 3、运输: 此类产品可按一般化学品运输, 小心在运输过程中泄漏。

六、声明公告 Declaration

- 1, 本文的数据是在各种实验和技术信息为基础而制作的, 由于使用条件的差异, 其使用方法和效果只供参考, 使用者在使用之前要参照这些数据和使用条件进行分析和试验, 确认该产品的特性和效果是否使用。
- 2, 本产品为化学产品, 产品性能与环境和工艺以及使用情况相关。故银久洲不担保在特定情况下使用时出现的问题, 并不承担任何直接、间接或意外损失责任。
- 3, 用户在特定情况下的使用过程中遇到任何问题, 请与银久洲技术服务部联系, 我们将会为您提供专业的服务。
- 4, 客户在使用前, 请务必进行必要的试验确认, 使产品适合您的工艺或用途, 产品可靠性取决于我们双方。
- 5, 我们保留对以上数据进行修改的权利。敬请客户使用本产品时, 以实测数据为准。